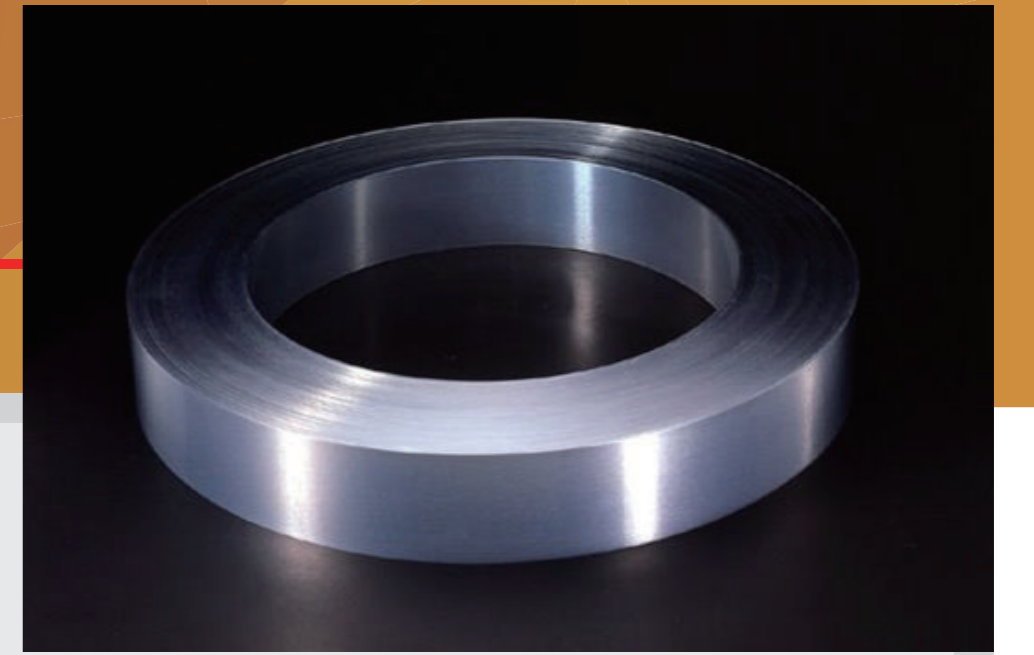


金属・樹脂フィルム積層材 アルセット™

Resin Film / Metal Laminates Alset™



概要

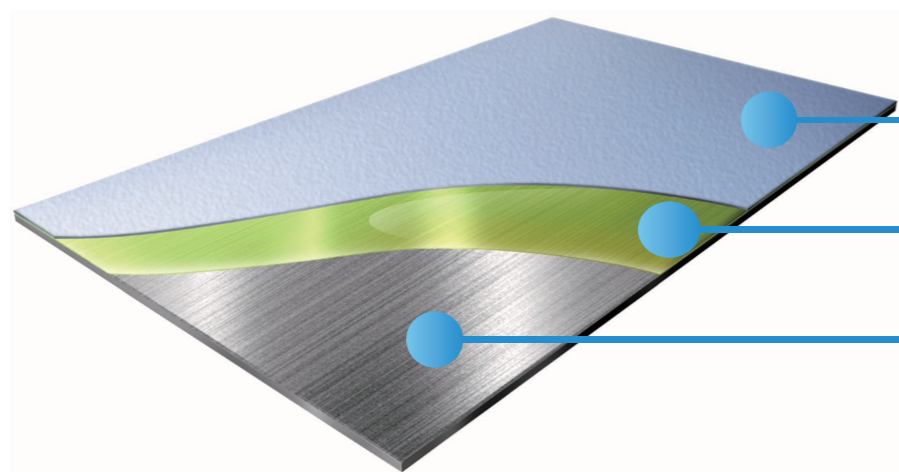
- ◆ アルセット™は、接着剤を使用せずに金属と樹脂フィルムを強力にラミネートした複合材料です。金属と樹脂フィルムの組み合わせを自由に選定できます。
 - 接着剤不使用のため、絞り加工等金属単体に近い加工が可能
 - 加工無しで金属に絶縁性等の性能を付与
 - 樹脂部品への電磁波シールド性や放熱性の付与が可能

技術詳細

- ◆ 幅は最大 50cm まで。対応できる幅は金属の厚み、種類によって異なるので個別にご相談ください。基本、樹脂フィルム層は片面貼りですが、両面貼りできる組み合わせもございます。

金属：アルミ、SUS、SECC、ZAM、銅（開発品）他

樹脂フィルム：PA、PP、UHMWPE、フッ素系、PET系、PC系／（開発中）PBT、PPS、PEI 他



樹脂フィルム (20 ~ 200μm)

特殊表面処理層 (一部組み合わせのみ)

金属 (100μm ~ 1 mm)

特徴・用途

◆ アルセット単体使用

- 絶縁フィルムラミネート工程の省略
- 金属塗装工程の省略
- 部品の小型化、省スペース化（絶縁距離の縮小）
- 絶縁 & 放熱の両立（樹脂と比較時）

想定用途

コンデンサーケース、
電池・電子部品ケース等

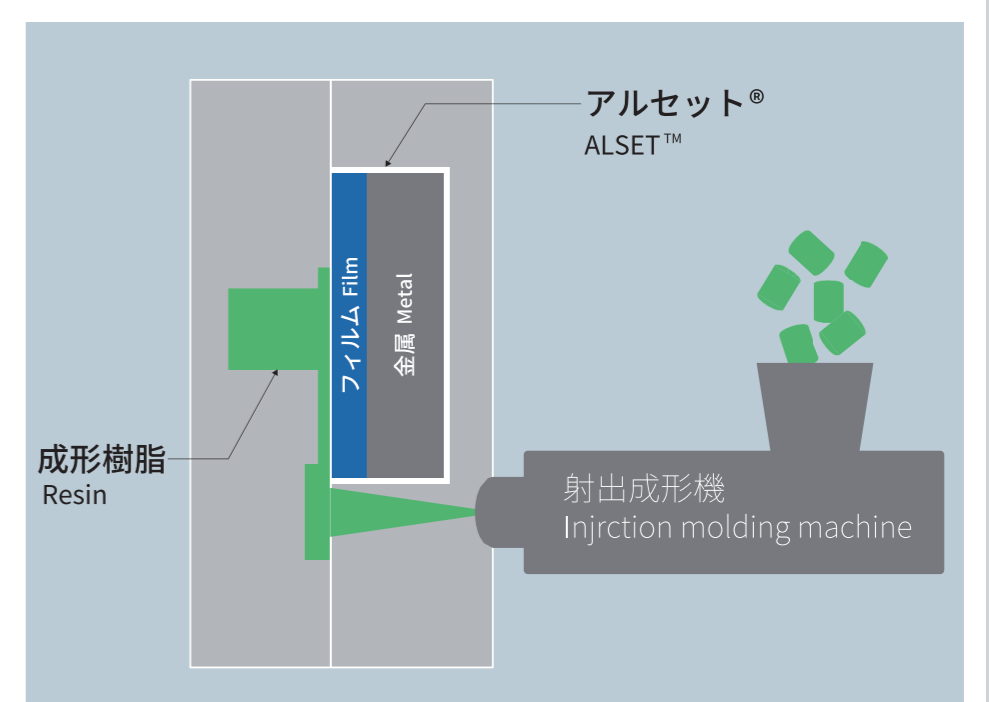


◆ 熱溶着用途

- アルセットのフィルム層と成形させたい樹脂が熱溶着可能な組み合わせの場合、フィルムと成形樹脂が金型内で熱溶着し、冷却後は一体化します。
- 熱のみで金属・樹脂を複合化
- 樹脂の電磁波シールド対応
- 金属軽量化
- 放熱性 UP

想定用途

インバーター筐体等



◆ 積層リジッド／フレキシブルバスバー

- アルセットを積層し、金属 / 樹脂 / 金属 / 樹脂 / 金属…という構成にすることで表層を増やして表皮効果を低減。高周波、且つ交流であれば同じ断面積で、より電流を流せるようになります。



樹脂(絶縁層)

単一金属、異種金属の組み合わせ可能（銅、アルミ等）